**授權同意書**

|  |
| --- |
| 為推廣科技部優良成果，積極協助產業技術升級，提升我國科技水準，厚植國家經濟發展基礎，並促進產學合作的機會，茲同意無償授權科技部工程科技推展中心將本人於中華民國 107 年 11 月 6~8 日舉行之中華民國第十四屆結構工程研討會暨第四屆地震工程研討會口頭發表論文  主題:  之錄影檔、聲音檔、照片、投影片、論文摘要及全文內容，予以數位典藏並上網公開播放。本資料僅供科技部工程司產學媒合之目的使用。  立同意書人：  身分證字號：  聯絡電話：  中華民國 年 月 日 |